

# 京都産業21 実施事業



Always Together

～明日へのチャレンジ応援します！～

# 令和3年度補助事業について

## 4/1 募集開始分

- ① 小規模企業等経営基盤強化支援事業（～5.31）
- ② 企業連携型ビジネス創出支援事業（～5.14）
- ③ 「産学公の森」推進事業（～5.31）

## 6/1 募集開始予定分

- ④ 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
- ⑤ 中小企業共同型ものづくり支援事業
- ⑥ 次世代地域産業推進事業

# 各補助事業の特徴

主な対象	生産性向上 経営基盤強化	新事業創出	社会課題解決	外部資金獲得
企業単独	<p>拡充</p> <p>小規模企業等 経営基盤 強化支援事業</p> <p>中小企業共同型 ものづくり 支援事業</p>	<p>京都エコノミッ ク・ガーデニン グ支援強化事業</p>		
産産 グループ		<p>新規</p> <p>企業連携型 ビジネス 創出支援事業</p>	<p>拡充</p> <p>「産学公の森」 推進事業</p>	
産学 グループ				<p>次世代地域 産業推進事業</p>

# 内容比較(募集中)

制度名	小規模企業等経営基盤強化支援事業	企業連携型ビジネス創出支援事業	「産学公の森」 （「企業の森・産学の森」）推進事業
趣旨	生産性の課題解決、社会経済環境に対応するための部材の内製化や販売方法の見直しなど経営基盤の強化を支援	業種の垣根等を超えた企業連携グループの形成から新ビジネスの創出に至るまでの取組を支援	産学公がそれぞれの強みを持ち寄り、総合的な観点から社会課題を解決する新たなビジネス・成長産業を創出する取組を支援
支援対象	企業単独	企業を核とした事業グループ (産産)	企業を核とした事業グループ (産産・産学)
支援分野	分野指定なし (経営基盤強化に繋がる事業が対象)	分野指定なし	分野指定なし
募集期間	R3.4.1 (木) ~ R3.5.31 (月)	R3.4.1 (木) ~ R3.5.14 (金)	R3.4.1 (木) ~ R3.5.31 (月)
補助率	一般：2分の1 (量産設備除く) 設備：15%		
対象経費	旅費、直接人件費、材料費・消耗品費、財産購入費等・備品購入費等、 外注・委託費、大学等研究機関との受託 (共同) 研究費、その他直接経費		
支援規模	500万円以内	I. 試作・実証コース 120万円以内	I. アーリーステージコース 120万円以内
		II. 事業展開コース 1000万円以内	II. 事業化促進コース 100万円以上~2,000万円以内
			III. 本格的な事業展開コース 2,000万円超~5,000万円以内 (1企業3,000万円以内)
対象期間	交付決定日~R3.12.31 (金) ※事前着手が認められた場合は4/1~可	交付決定日~R4.1.31 (月) ※事前着手が認められた場合は4/1~可	
採択予定	小規模企業15~30件程度 中小企業5~10件程度	I 50件・II 15件程度	I 11件・II 8件・III 5件程度

※本3補助金は併願申請できません。

# 内容比較(6/1募集開始予定分)

制度名	京都エコノミック・ガーデニング 支援強化事業	中小企業共同型ものづくり支援事業 (シェアリング事業)	次世代地域産業推進事業
趣旨	新たな商品・サービス・ビジネスモデル等の開発、新分野進出等を支援	情報や機器の共有により中小企業の連携を高め、生産性・競争力の向上を支援	先端技術を活用して事業化を目指す「産学連携グループ」の民間資金等の獲得に向けた取組を支援
支援対象	企業単独	企業グループ・組合・企業単独	大学等研究機関が参画したグループ (産学)
支援分野	分野指定なし	情報や機器の共有により生産性・競争力の向上を目指す取組全般	分野指定なし (ただし、「脳科学」「AI」「iPS細胞」を重点支援テーマとする)
募集期間	R3.6.1(火)～R3.7.30(金)(予定)		
補助率	一般：2分の1(量産設備除く) 設備：15%	2分の1	
対象経費	旅費、直接人件費、材料費・消耗品費、財産購入費等・備品購入費等、 外注・委託費、大学等研究機関との受託(共同)研究費、その他直接経費		
支援規模	I.事業創生コース 100万円以内  II.事業化促進コース 1,000万円以内  III.本格的事業展開コース 3,000万円以内	I.シェアリング事業 II.シェアリングサポート事業 (1)企業グループ 5,000万円以内 (1企業3,000万円以内) (2)組合 3,000万円以内 (3)企業単独 3,000万円以内  ※ただし、計画策定のみ場合は 1事業120万円以内	1,000万円以内
対象期間	原則として交付決定日から12ヶ月間		
採択予定	I 20件・II 10件・III 10件程度	7件程度	5件程度

※内容は募集時に変更する可能性があります。

# 今年度補助金の主なポイント

## ◆全補助金共通

- 同種のテーマでなければ、昨年度の採択事業者も申請可  
(同種のテーマでのコースのステップアップは可)

## ◆「産学公の森」推進事業

- 「社会課題」の解決に対する寄与度が高い事業は審査時に考慮。
- 構成企業が「スタートアップ企業※」に該当する場合は審査時に考慮。
  - ※下記の2要件を満たす企業
    - 1) 創業10年以内で国内に拠点を持つ未上場の企業
    - 2) バイオ、AI・IoT、データサイエンス、ロボティクス、xR等の最先端技術  
又は大学等研究機関の研究シーズを活用した新たな製品・サービスの開発  
を目指す企業
- 府外「スタートアップ企業」を補助金交付対象に追加
  - 「スタートアップ企業」においては、京都府内に拠点が無い場合であっても、財団理事長が認める場合に限り補助金の交付対象企業とします。

# 令和3年度「海外出願・侵害対策支援事業」について

## 1 内 容

外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の登録・出願に要する経費の一部を補助します。

## 2 公 募

(1) 受付期間 **令和3年5月6日(木)～5月21日(金)**

(2) 応募資格 ■京都府内に本社を置く中小企業者等（みなし大企業を除く）

地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人

■申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等（PCT出願含む）を行っている出願であって、以下のいずれかに該当する方法により、**令和3年12月20日(月)**までに外国特許庁へ同一内容の出願を行った上で弁理士に支払を完了し、**令和4年1月20日(木)**までに京都産業21へ実績報告書を提出予定であること。

- ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
- ・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（PCT出願を同国の国内段階に移行する方法）
- ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
- ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

■**交付決定前に外国出願した案件は対象となりません（弁理士への発注を含む）。**

**また、交付決定前に発生した費用（例えば翻訳費）についても補助対象になりません。**

【公募要領及び申請書ダウンロード】 <https://www.ki21.jp/kobo/r3/tokkyo/index.html>

- (3) 補助内容
- 採択予定件数 特許10件 実用新案1件 意匠1件 商標及び冒認対策商標5件
  - 補助率 1/2以内
  - 1企業の補助金総額(1会計年度内：消費税等を除く) 300万円以内/年
  - 1出願別の補助金額(1会計年度内：消費税等を除く)
    - (イ) 特許 150万円以内/件
    - (ロ) 実用新案、意匠または商標(冒認対策商標は除く) 60万円以内/件
    - (ハ) 冒認対策商標 30万円以内/件
  - 補助対象経費
    - ・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など
    - ・1企業の上限額は京都産業21の他に、日本貿易振興機構(JETRO)・京都高度技術研究所(ASTEM)で各々採択された場合はその合計額となります。
    - ・補助金申請額は補助対象経費を1/2にした後、1,000円未満は切り捨てです。
    - ・日本国特許庁への出願経費及び消費税、海外付加価値税(VAT)等は対象外です。

(詳細は京都産業21までお問い合わせください)
- (4) 採択決定 審査日： 令和3年6月18日(金)(予定)  
採択事業者決定： 7月初旬(予定)
- (5) 提出方法 持参(5月21日までの平日 午前9時~正午及び午後1時~午後5時) 又は、  
郵送(5月21日(金)の消印有効)。  
締切日の午後5時までに電子メールによる提出も可能です。
- (6) 提出先及び問合せ先 (公財) 京都産業21 事業成長支援部 企業支援グループ  
TEL：075-315-9425 E-mail：[sangaku@ki21.jp](mailto:sangaku@ki21.jp)  
応募を検討される場合は(公財)京都産業21まで事前にご相談下さい。



御不明な点はお気軽にお問合せください。

公益財団法人京都産業 2 1 事業成長支援部

電話 : 075-315-9425

E-mail : [sangaku@ki21.jp](mailto:sangaku@ki21.jp)